



THERMO FASADA STANDARD

2026-07-31_PL

- Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_0 \leq 0,042$ [W/(m·K)]
- Klasa reakcji na ogień Klasa E
- Wymiary płyt 1000 x 500 mm
- Krawędzie proste i frezowane

ZASTOSOWANIE:

Wypełnienie ścian szczelinowych z wentylowaną i nie wentylowaną szczeliną powietrzną,
Pionowa izolacja dylatacyjna ścian zewnętrznych,
Wypełnienie konstrukcji wewnętrznych ścianek działowych,
Wypełnienie konstrukcji ścian szkieletowych z okładziną,
Ocieplenie stropów od spodu z okładziną,
Wypełnienie podłóg między legarami,
Wypełnienie lekkich stropów szkieletowych z okładzinami,
Wypełnienie dachów stromych między krokiewiami,
Ocieplenie stropodachów wentylowanych,
Ocieplenie ścian zewnętrznych w systemach BSO.

WŁAŚCIWOŚCI PŁYT STYROPIANOWYCH

Kod oznaczenia wyrobu wg specyfikacji technicznej EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80-MU20		
WŁAŚCIWOŚCI	KLASA LUB POZIOM	WYMAGANIE
Grubość	T(1)	± 1 mm
Długość	L(2)	± 2 mm
Szerokość	W(2)	± 2 mm
Prostokątność	Sb(5)	± 5 mm/m
Płaskość	P(5)	≤ 5 mm
Wytrzymałość na zginanie	BS75	≥ 75 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych (23°C, 50% wilgotności względnej)	DS(N)2	± 0,2 %
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności (48h, 70°C)	DS(70,-)2	± 2,0 %
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych	TR80	≥ 80 kPa
Przepuszczalność pary wodnej	MU20	μ 20÷40
Reakcja na ogień	Euroklasa	E
Współczynnik przewodzenia ciepła	λ_0	≤ 0,042 [W/(m·K)]
Opór cieplny	R ₀	Patrz tabela poniżej

DEKLAROWANY OPÓR CIEPLNY R₀ DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUBOŚCI WYROBU:

Grubość płyty [mm]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Opór cieplny R ₀ [m²·K/W]	0,20	0,45	0,70	0,95	1,15	1,40	1,65	1,90	2,10	2,35	2,60	2,85	3,05	3,30	3,55
Ilość płyt w paczce [szt.]	60	30	20	15	12	10	8	7	7	6	5	5	5	4	4
Krawędzie proste															
Objętość paczki [m³]	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,280	0,280	0,315	0,300	0,275	0,300	0,325	0,280	0,300
Powierzchnia krycia [m²]	30,00	15,00	10,00	7,50	6,00	5,00	4,00	3,50	3,50	3,00	2,50	2,50	2,50	2,00	2,00
Krawędzie frezowane															
Objętość paczki [m³]	-	-	-	-	0,285	0,285	0,266	0,266	0,299	0,285	0,261	0,285	0,308	0,266	0,285
Powierzchnia krycia [m²]	-	-	-	-	5,70	4,75	3,80	3,32	3,32	2,85	2,37	2,37	2,37	1,90	1,90
Grubość płyty [mm]	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Opór cieplny R ₀ [m²·K/W]	3,80	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,20	5,45	5,70	5,95	6,15	6,40	6,65	6,90	7,10
Ilość płyt w paczce [szt.]	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
Krawędzie proste															
Objętość paczki [m³]	0,320	0,255	0,270	0,285	0,300	0,315	0,330	0,230	0,240	0,250	0,260	0,270	0,280	0,290	0,300
Powierzchnia krycia [m²]	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Krawędzie frezowane															
Objętość paczki [m³]	0,304	0,242	0,257	0,271	0,285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Powierzchnia krycia [m²]	1,90	1,43	1,43	1,43	1,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

UWAGA: Grubość płyt w każdym opakowaniu należy odczytać z oznaczenia na górnej krawędzi paczki (GR mm).

PAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE: Płyty styropianowe dostarczane są w oryginalnych opakowaniach zawierających etykietę ze szczegółową informacją o wyrobie. Należy je przechowywać zabezpieczając przed uszkodzeniami mechanicznymi i oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Wierzchnia warstwa styropianu może ulec utlenieniu w przypadku długotrwałego działania promieni UV.

UWAGA: Nie stosować płyt styropianowych w bezpośrednim kontakcie z rozpuszczalnikami organicznymi (aceton, benzen, nitro) oraz materiałami, które je zawierają.

WYKONANIE: Mocować do podłoża za pomocą przeznaczonych do tego celu klejów na bazie cementu, pian poliuretanowych lub mas bitumicznych na bazie dyspersji wodnych lub innych. Zewnętrzna warstwa płyt styropianowych musi być zabezpieczona przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych poprzez wykonanie warstwy zbrojonej i nałożenie tynku w systemach ociepleń lub inną warstwą ochronną w pozostałych przypadkach. Płyty układać zgodnie z projektem budowlanym, stosując się do ogólnych zasad tzn. z odpowiednim przesunięciem, zapobiegającym nakładaniu się styków płyt.